

報道関係者各位

2024年5月31日  
サワイグループホールディングス株式会社

## ソーシャルボンド条件決定のお知らせ

サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎、以下、当社）は、4月22日に「当社初のソーシャルボンド発行に関するお知らせ」で公表しましたソーシャルボンド※（以下、本社債）について、本日、以下のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

※社会課題の解決に資する事業の資金を調達するために発行される債券

## 1. 本社債の概要

名称	サワイグループホールディングス株式会社第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (ソーシャルボンド)
発行額	100億円
年限	5年
利率	1.132%
条件決定日	2024年5月31日
払込期日	2024年6月6日
償還期日	2029年6月6日
主幹事証券会社	SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント※	SMB C日興証券株式会社
資金用途	沢井製薬株式会社第二九州工場（福岡県飯塚市）で計画中の新固形剤棟建設に係る投資に充当する予定

※「ストラクチャリング・エージェント」とは、ソーシャルファイナンス・フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、ソーシャルボンドの発行支援を行う者のことです。

## 2. ソーシャルファイナンス・フレームワークとセカンドオピニオン

当社は本社債の発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）が定めるソーシャルボンド原則等に則り、ソーシャルファイナンス・フレームワーク（以下、本フレームワーク）を策定し、上記原則等との適格性について、独立した外部評価機関である株式会社格付投資情報センター（R&I）よりセカンドオピニオンを取得しています。

## ◆ 報道関係者様お問い合わせ先 ◆

サワイグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部  
TEL：06-6105-5718/E-mail：koho@sawaigroup.holdings